

2011年9月26日

第9回産学官連携功労者表彰授与式において内閣総理大臣賞を受賞

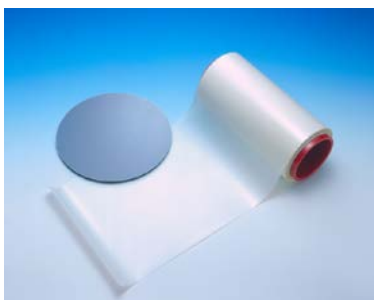
日立化成工業株式会社(本社:東京、執行役社長:田中 一行、資本金:155億円)は、このたび「電子機器の小型化・大容量化を可能とする半導体接着技術 ～ダイボンディングフィルムの開発～」において、第9回産学官連携功労者表彰の内閣総理大臣賞を受賞し、先般9月22日(木)東京国際フォーラムにて授与式が執り行われました。

産学官連携功労者表彰とは、大学、公的研究機関、企業等における産学官連携活動において大きな成果を収め、また、先導的な取り組みを行う等、産学官連携の推進に多大な貢献をした優れた成功事例に関し、その功績を称えることにより、我が国の産学官連携の更なる進展に寄与することを目的とするものです。

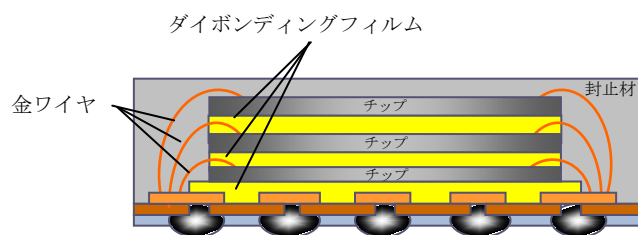
ダイボンディングフィルムは、多段積層化が進む半導体チップの接着に不可欠な超薄型フィルム状接着剤です。当社は山形大学の井上教授と連携し、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「精密高分子技術プロジェクト」の成果を活用することで、柔軟性に優れるアクリルポリマと接着性に優れるエポキシ樹脂からなる相分離構造をナノレベルで制御することにより、10マイクロメートルの薄さを実現し、かつ柔軟性と高い接着信頼性を有する製品へと進化させてまいりました。ダイボンディングフィルムは、世界シェアの過半を得て半導体積層技術のデファクトスタンダードとなっており、携帯電話、ノートPC、フラッシュメモリ、スマートフォン、タブレット端末等にも採用され、最新電子機器の高機能化、大容量化、小型化にも貢献しています。

<受賞事例>

電子機器の小型化・大容量化を可能とする半導体接着技術
～ダイボンディングフィルムの開発～



ダイボンディングフィルム



半導体パッケージでの使用例

<受賞者>

日立化成工業株式会社 筑波総合研究所 基盤技術開発センタ
稲田 禎一 主管研究員
山形大学 大学院 理工学研究科 機能高分子工学専攻
井上 隆 客員教授 (東京工業大学 名誉教授)



内閣総理大臣賞プレゼンテーションの様子(当社 稲田貞一氏)



表彰式後の記念撮影

(左から、山形大学 井上隆氏、総合科学技術会議議員 相澤益男氏、当社 稲田禎一氏)

当社は、今後もダイボンディングフィルムの開発を通じて、電子機器のさらなる高機能化、大容量化、小型化に貢献してまいります。

以上

(報道関係お問い合わせ) 日立化成工業株式会社 コーポレートコミュニケーションセンタ

広報担当 長谷川、磯田 TEL 03-5381-2384